経済産業省

資料３

# 第４回　次世代半導体等小委員会

2025年7月

商務情報政策局

１．計画の記載事項項目について
２．審査基準等について
３．金融支援に当たっての考え方について
４．半導体の指定について

# １．計画の記載事項項目（案）

| | 想定項目 |
|---|---|
| 技術開発面 | 生産開始時期 |
| | 現時点の技術的基礎と今後の技術開発に係る計画 |
| | 技術流出対策（「コア技術」の流出防止に係る事項を含む） |
| 事業面 | 事業戦略（ターゲット市場の成長性、競合との差別化、顧客確保の見込み等） |
| | 設備投資に係る計画 |
| | 製造装置・原材料等の安定調達に係る取組 |
| | 人材確保に係る取組 |
| 財務・ガバナンス面 | 財務計画（P/L,B/S,C/F） |
| | 資金調達計画（特に民間からの資金調達の見込み） |
| | 株式設計 |
| | 経営体制及び企業統治体制 |
| その他 | 国、地方公共団体その他の関係者との連携 |
| | 我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与 |
| | その他（公募参加資格等） |

（注）リスクシナリオが想定される項目については、その内容と対応策を記載

# 2．審査基準①（技術開発面）（案）

| | 項目 | 審査基準 | 評価基準 |
|---|---|---|---|
| **①技術開発面** | 生産開始時期 | 2020年代後半に我が国において公募対象半導体の生産※を開始すること。<br>※単なる試作ではなく、顧客との継続的な取引を念頭に置いた商用生産 | ○ |
| | 現時点の技術的基礎と今後の技術開発 | ・公募対象半導体の生産を行うに足りる技術的な基礎を有していると認められること。<br>・公募対象半導体の生産を開始するとともに、事業を継続的に実施していくために必要な今後の技術開発に係る計画が適切であると認められること。<br><br>※確認項目としては以下を想定。<br>（前工程）<br>①製造技術・フローの開発、②生産設備（搬送装置等）の開発、<br>③EUV露光技術の開発、④パイロットラインの構築、⑤テストチップの試作、⑥歩留まり改善、<br>⑦PDK・IPの開発等<br>（後工程）<br>①パッケージ製造技術・フローの開発、②パッケージ設計技術の開発、③良品チップ選別技術開発、④パイロットラインの構築等 | ○ |
| | 技術流出対策 | 公募対象半導体の生産に係る技術上の情報を適切に管理するための体制が整備されていること。<br>加えて、「コア技術」の流出を防止するため、①～④を実施するものであること。<br>①コア技術等の適切な管理体制や規程の整備<br>②コア技術等を扱う者への対応（守秘義務誓約、適切な待遇）<br>③取引先企業との秘密保持契約締結等<br>④コア技術等の技術移転により、懸念国での製造拡大を行う際の経産省への事前相談 | ― |

# 2．審査基準②（事業面）（案）

| | 項目 | 審査基準 | 評価基準 |
|---|---|---|---|
| ②事業面 | 事業戦略 | ・事業戦略について、以下の観点等も踏まえ、適切であると認められること。<br>※ターゲットとする市場の成長性や需給見通し等のマクロ的な観点からの市場獲得の可能性<br>※競合他社との差別化（知的財産に係る取組も含む）<br>※顧客とのコミュニケーション状況等も踏まえた顧客獲得の見込み（国内顧客についても確認） | ○ |
| | 設備投資 | ・市場における需給及び競争環境、顧客獲得の見込み等に照らして、設備投資に係る計画が適切であると認められること。 | ○ |
| | 製造装置・原材料等の安定的な調達 | 製造装置・原材料等の安定的な調達に係る取組が適切であると認められること。<br>※関連事業者とのコミュニケーション状況、輸送経路・体制等も確認する。<br>※工業用水等の確保に係る取組についても確認する。 | ○ |
| | 人材確保 | 技術者等の人材確保に係る取組が適切であると認められること。<br>※半導体人材育成に取り組む産学連携組織への加入・参加状況、関係する教育機関、研究機関又は技術研究組合等との連携状況等も確認する。 | ○ |

# 2．審査基準③（財務・ガバナンス面）（案）

| | 項目 | 審査基準 | 評価基準 |
|---|---|---|---|
| ③財務・ガバナンス面 | 財務計画 | ・事業戦略及び設備投資に係る計画等を踏まえ、賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の財務計画が適切であると認められること。<br>・特定取組の実施期間内に、営業CFの継続的な黒字が見込まれるとともに、営業利益やFCF（※）の黒字化が見込まれること。<br>・政府からの金融支援を伴わない民間からの資金調達を図る観点や競合他社の水準も踏まえ、特定取組の実施期間内において、自己資本比率が適正な水準になっていると見込まれること。<br>（※）FCF（フリーキャッシュフロー）とは、営業CF（営業活動等による現金収支）から投資CF（設備投資）を引いたもの。 | ○ |
| | 資金調達 | ・政府からの金融支援がなければ、必要かつ十分に特定取組を行うことが困難であると認められること。<br>・必要な資金に対して十分な資金調達が計画されており、民間からの資金調達が最大限図られていると認められること。<br>・特定取組の実施期間内に、政府からの金融支援を伴わない民間からの資金調達が見込まれていること。 | ○ |
| | 株式設計 | ・政府からの出資を受ける場合にあっては、次の①から④の政府の出資方針について受け入れること。<br>①経営判断の迅速性等にも配慮しつつも、一定の議決権を有すること。<br>②経営に不測な事態が発生した場合等において、機動的な対応を行うべく、能動的にガバナンスを発揮できるようになっていること。<br>③重要な経営事項に対して拒否権を有する拒否権付き種類株式を保有すること。<br>④民間からの資金調達を促進していきつつも、公的資金の回収が最大限見込まれること。<br>※公的資金の回収の見込みについて確認する。 | ― |
| | 経営体制及び企業統治体制 | 経営体制及び企業統治体制が適切であると認められること。<br>※事業者の資本関係についても確認する。 | ― |

# 2．審査基準④（その他）（案）

| | 項目 | 審査基準 | 評価基準 |
|---|---|---|---|
| ④その他 | 国、地方公共団体<br>その他の関係者との連携 | 国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策（半導体に係る人材育成や研究開発及び実証に関する施策等）との連携を十分に行うことができる体制を有し、又は有することが見込まれること。 | － |
| | 我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与 | 特定取組の実施が、我が国経済社会の発展、地域経済の活性化にも寄与するものとなるよう努めるとともに、その寄与の度合いの試算等※をすること。<br>※例えば、雇用創出、投資誘発効果、関連産業への経済波及等<br><br>また、サプライチェーンの検討・構築に当たっては、国内事業者（特に中小企業者）を可能な限り参画させるよう努めること。 | － |
| | その他事項 | ✓ 公募参加資格（反社会的勢力ではないこと等）を満たすこと<br>✓ 事業者が、過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準に反していないこと。<br>✓ 外国の法的環境等により取組の適切性が影響を受けるものでないこと。<br>✓ BCPが策定されていること。<br>✓ 国内関係法令を遵守すること。<br>✓ サイバーセキュリティの確保に関する対策が講じられていること。<br>✓ 必要に応じて計画を見直すこと。　等 | － |

※　複数の事業者が審査基準を満たした場合は、審査基準項目の一部について相対的な優劣をつけていく。

# ３．金融支援に当たっての考え方（案）について

**（ファウンドリー事業の特性を踏まえた支援）**

- ファウンドリー企業の自己資本比率は他業界に比しても高く、今後、多様な方法で資金調達を図っていくことが想定される中で、十分な自己資本を備えていくことが必要である。
- 次世代半導体の量産はリスクの高い野心的な取組であり、民間からの資金調達を最大化する方針を基本としつつも、政府からの資金調達支援の柔軟性を確保していくことも重要。

**（モラルハザードの防止）**

- 債務保証については、モラルハザードを防ぐ観点も踏まえ、事業者の債務の全額を保証することはしないものとする。

**（議決権行使の基準）**

- 経営への関与の在り方については、基本的には、経営の迅速性等に配慮しつつ、事業者の経営判断を尊重する。その上で、議決権の行使に当たっては、本金融支援の目的である次世代半導体の製造基盤を確立するという政策的観点等を踏まえて、適切に行使すること。

**（保有株式の処分の基準）**

- 保有株式の処分に当たっては、株式市場の状況や事業者の経営状況等を踏まえながら、適切なタイミングで株式を処分していくことで、公的資金の回収を最大限図っていく。

# ４．指定高速情報処理用半導体の指定（案）

- 情促法第61条第１項「経済産業大臣は、政令で定める種類ごとに次の各号のいずれにも該当する半導体を指定することができる。」の規定を受けて、種類（ロジック半導体、メモリ半導体）を政令で定めた上で、**具体的に公募の対象とする半導体を、告示において指定高速情報処理用半導体として指定**する。
- まずは、**２ナノ以下（以細）のロジック半導体を指定**することする。
- 具体的には、**「演算を行う半導体であって、面積が〇・〇一八七平方マイクロメートル以下の電子回路（六個のＧＡＡ構造のトランジスターで構成されるものに限る。）をその内部に含むものとする。」**とする。
  ※ここでの演算を行う半導体とは、チップそのものに限らず、チップと同一パッケージ内に集積するチップレット製品を含む。
  ※チップやパッケージの中に、演算機能だけでなく、メモリ等の演算以外の機能も集積したチップも含む。